

COMUNICATO STAMPA

- **Ricevuta comunicazione dall'azionista di controllo T-PLUS S.p.A., con la quale si rende nota la sottoscrizione di un accordo vincolante per la cessione ad Advantest Europe GmbH, società interamente controllata da Advantest Corporation, di azioni di Technoprobe S.p.A. pari al 2,5% del capitale sociale di quest'ultima, con conseguente cessazione degli impegni di *lock-up* previsti dagli accordi parasociali in essere con Teradyne International Holdings B.V.**
- **Technoprobe S.p.A. annuncia la sottoscrizione di accordi per la creazione di una *partnership* strategica con Advantest Corporation per lo sviluppo e fornitura di PCBs (Printed Circuit Boards)**

Cernusco Lombardone (LC), 7 gennaio 2025 - Technoprobe S.p.A. (FTSE Italy Mid Cap: TPRO), società *leader* nella progettazione e produzione di Probe Card ("**Technoprobe**" o la "**Società**"), rende noto di aver ricevuto in data odierna la comunicazione di T-PLUS S.p.A. ("**T-PLUS**"), azionista che controlla di diritto la Società, indirizzata a quest'ultima e a Teradyne International Holdings B.V. ("**Teradyne International**") ed effettuata ai sensi dell'accordo di investimento contenente pattuizioni parasociali sottoscritto in data 7 novembre 2023 (l' "**Accordo**"), di aver sottoscritto un accordo vincolante per la cessione di azioni Technoprobe, pari al 2,5% del capitale sociale di quest'ultima, ad Advantest Europe GmbH, società interamente controllata da Advantest Corporation (Tokyo Stock Exchange, Prime Market: Advantest Corp. 6857), società *leader* nella progettazione e produzione di apparecchiature di collaudo automatico (ATE). Il trasferimento avverrà mediante un'operazione regolata fuori mercato. La suddetta comunicazione assume rilevanza in quanto determina, ai sensi dell'art. 4.3(iii) dell'Allegato A dell'Accordo, il venir meno degli impegni di *lock-up* relativi alla partecipazione nel capitale di Technoprobe acquistata da Teradyne International mediante l'Accordo.

A seguito della cessione del 2,5% di azioni Technoprobe, T-PLUS deterrà una partecipazione del 57,96% al capitale sociale della Società ed il 70,47% dei diritti di voto.

Technoprobe annuncia, inoltre, di aver firmato nei giorni scorsi alcuni accordi con Advantest Corporation per la costituzione di una *partnership* commerciale e strategica per lo sviluppo e fornitura di PCBs (Printed Circuit Boards).

Stefano Felici, Amministratore Delegato di Technoprobe S.p.A., ha commentato: "*Lo scorso anno abbiamo iniziato ad ampliare le nostre competenze nel segmento Device Interface Boards ed oggi confermiamo la rilevanza di questo pilastro strategico. La posizione di leadership acquisita da Technoprobe nel testing dei chip non-memory di fascia alta, anche nel segmento dell'Intelligenza Artificiale, ci ha permesso di rafforzare il rapporto commerciale con Advantest Corporation, leader nelle piattaforme ATE nello stesso segmento di mercato. Come risultato dell'accordo con Advantest*



Technoprobe S.p.A.
Via Cavalieri di Vittorio Veneto, 2
23870, Cernusco Lombardone (LC) - Italy
www.technoprobe.com

Corporation e al fine di ottimizzare la struttura dei costi del Gruppo, le attività di manifattura di Harbor Electronics negli Stati Uniti cesseranno entro la fine del primo trimestre 2025”.

Gli accordi prevedono che le società del Gruppo Technoprobe si avvarranno delle società del Gruppo Advantest quali fornitori prioritari per l’acquisto di *probe card PCBs*, di *test board PCBs* e di altre *PCB solutions* che potranno essere congiuntamente definite tra le parti. La durata iniziale dell’accordo è triennale con successivi rinnovi automatici annuali.

Contestualmente Technoprobe conferma la cessazione delle attività di produzione di PCBs presso lo stabilimento produttivo di Santa Clara (CA) operato dalla propria controllata americana Harbor Electronics, Inc. mantenendo comunque il *know-how* acquisito relativamente a specifici processi di assemblaggio di componenti delle proprie probe card presso lo stabilimento di Fremont (CA).

La posizione di leadership di Technoprobe e Advantest Corporation nello sviluppo, produzione e commercializzazione di prodotti per il testing dei chip AI nella fascia alta di mercato, rappresenta il punto di forza della partnership che si pone come obiettivo il mantenimento del posizionamento raggiunto grazie alle sinergie derivanti dalla condivisione della roadmap tecnologica.

Il presente comunicato stampa è disponibile sul sito di Technoprobe, nella sezione **Investor Relations** e sul meccanismo di stoccaggio autorizzato “**eMarket Storage**” (www.emarketstorage.it).

Contatti

Technoprobe S.p.A.
Investor Relator
Ines Di Terlizzi
Email: ir@technoprobe.com

Technoprobe S.p.A.
Communication & Marketing Manager
Paolo Cavallotti
Email: paolo.cavallotti@technoprobe.com

Gruppo Technoprobe

Technoprobe è un’azienda leader nel settore dei semiconduttori e della microelettronica. Costituita nel 1996, Technoprobe è specializzata nella progettazione e realizzazione di interfacce elettro-meccaniche denominate Probe Card (schede sonda) per il test di funzionamento dei chip. Le Probe Cards sono dispositivi ad alta tecnologia - fatti su misura sullo specifico chip – che consentono di testare il funzionamento dei chip durante il loro processo di costruzione. Si tratta di progetti e soluzioni tecnologiche che garantiscono il funzionamento e l’affidabilità dei dispositivi che hanno un ruolo determinante nell’industria dell’Information Technology, del 5G, dell’Internet of Things, della domotica, dell’automotive, dell’aerospaziale. Technoprobe ha il suo headquarter in Italia, a Cernusco Lombardone (LC). Dal 2 maggio 2023, Technoprobe è quotata sul mercato Euronext Milan. Per maggiori informazioni: www.technoprobe.com

Technoprobe S.p.A. - Partita IVA e Codice Fiscale 02272540135 - Capitale Sociale di € 6.532.608,70 - R.E.A. 283619

All rights reserved. The COPYRIGHT of this document is property of TECHNOPROBE S.p.A. No part of this document may be copied, reprinted or reproduced in any material form, whether wholly or in part, without a written consent. The contents or methods or techniques contained herein are CONFIDENTIAL, therefore must not be disclosed to any other person or company or entity.